

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<u>2024年8月8日</u> 诚通基金、长江养老保险、淡水泉投资、嘉实基金、汇安基金、信达澳亚基金、易米基金、中移资本等 <u>2024年8月9日</u> 公开业绩说明会
时间	2024年8月8日，2024年8月9日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP

IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐

	<p>步转好，2024年第二季度，公司实现营业收入6.14亿元，较第一季度环比增长92.96%；2024年第二季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-0.78亿元，亏损较第一季度大幅收窄62.40%。</p> <p>公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位，截至2024年二季度末，公司在手订单22.71亿元，预计一年内转化的比例约为81%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司在自动驾驶领域的技术布局与客户合作情况如何？</p> <p>回复：近年来，公司聚焦快速增长的汽车电子领域，芯片设计流程已获得ISO 26262汽车功能安全管理体系认证，通过这个认证将加速公司在电动汽车和智能汽车领域的战略布局；此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC平台的总体设计流程，以及基于该平台的高级驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。</p> <p>基于上述技术布局，芯原已经积累了为汽车厂商设计高性能车规ADAS芯片的相关经验，例如为某知名新能源汽车厂商提供基于5nm车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，其中集成了芯原的多个半导体IP，并符合ISO 26262功能安全标准，性能全球领先。目前芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。</p> <p>问题：请问公司如何展望未来境外收入占比？</p> <p>回复：公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展，长期来看，公司境外收入占比约占整体收入的三成左右。在2024年上半年，公司实现境内销售收入6.03亿元，占营</p>

业收入比重为 64.72%；境外销售收入 3.29 亿元，占营业收入比重为 35.28%。

问题：请问公司 GPU IP 技术的研发进展如何？

回复：芯原 GPU IP 已经耕耘嵌入式市场近 20 年，在多个市场领域中获得了客户的采用，包括数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC 等，内置芯原 GPU 的客户芯片已在全球范围内出货近 20 亿颗。

具体来看，芯原在汽车电子领域与全球知名的头部企业合作，已被广泛应用于车载娱乐系统和可重构仪表盘；公司的 2D GPU 可以达到 3D 的效果，被大量应用于可穿戴领域产品，例如智能手表，支持显示功能的 MCU 等；此外，芯原在桌面显示渲染方面也有长期的技术积累，可为 PC/服务器领域的客户提供服务。芯原 GPU 还可以和公司自主知识产权的神经网络处理技术融合，支持图形渲染、通用计算以及 AI 处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器提供大算力通用处理器平台，并利用统一的软件接口和一体化的编译器，让用户可以使用标准编程接口来驱动不同的硬件处理器单元。芯原自主知识产权的通用图形处理器（GPGPU）可以支持大规模通用计算和生成式 AI（AIGC）相关应用，现已被客户采用部署至各类高性能 AI 芯片中，面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。目前，公司 GPU 相关在研项目“面向数据中心和 GPU AI 计算的高性能图形处理器技术”项目进展顺利。

问题：科创板鼓励并购整合，公司在这方面有无考虑？

回复：作为半导体 IP 和一站式芯片定制服务平台的行业龙头，芯原非常适合做并购。芯原多年以来一直坚持以内部自主研发为主，在自主创新的同时适时对芯原所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新，在此过程中，芯原的 IP 得到了充实，芯片定制能力也逐渐变强。未来，公司将继续依托平台化公司的行业理解，积极推进产业生态

建设，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购公司，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

问题：请问公司近期 Chiplet 业务的最新进展有哪些？

回复：随着各行各业进入人工智能升级的关键时期，市场对于大算力的需求急剧增长。在此背景下，集成电路行业正经历从 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）的转型，这一转变是出于对高性能单芯片集成度与复杂性的提升、性能与功耗的优化、良率与设计/制造成本改善等多方面的考量。为了适应这一发展趋势，芯原正在将其在 SoC 中扮演重要角色的半导体 IP（知识产权）升级为 SiP 中的核心组件——Chiplet，并基于此构建 Chiplet 架构的芯片设计服务平台。

公司再融资募投项目之一为“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”，并形成基于 Chiplet 架构的软硬件芯片设计平台，对公司现有技术有如下提升：1）结合公司 IP 技术、芯片软硬件设计能力等，新增高算力 GPGPU Chiplet、AI Chiplet 和主控 Chiplet；2）新增 Die to Die 接口 IP 及相关软件协议栈；3）强化先进封装技术的设计与应用能力；4）开发基于 Chiplet 架构的可扩展大算力软硬件架构。

目前，公司 Chiplet 业务进展顺利，芯原已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的高端应用处理器，采用了 MCM 先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的高算力 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe/BoW 兼容的物理层接口；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者蓝洋智能合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。